

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2001年4月26日 (26.04.2001)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 01/28726 A1

- (51) 国際特許分類: B23K 1/20 Mitsuo) [JP/JP]; 〒340-0035 埼玉県草加市西町1354-8 Saitama (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP99/05777
- (22) 国際出願日: 1999年10月20日 (20.10.1999) (74) 代理人: 弁理士 広瀬章一 (HIROSE, Shoichi); 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4丁目4番2号 東山ビル Tokyo (JP).
- (25) 国際出願の言語: 日本語 (81) 指定国 (国内): US.
- (26) 国際公開の言語: 日本語 (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 千住金属工業株式会社 (SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD.) [JP/JP]; 〒120-8555 東京都足立区千住橋戸町23番地 Tokyo (JP). 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- (72) 発明者; および 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 禅 三津夫 (ZEN,

(54) Title: SOLDER COATING MATERIAL AND PRODUCTION METHOD THEREFOR

(54) 発明の名称: はんだコーティング材とその製造方法

(57) Abstract: A method that can deposit a sufficient amount of solder without using flux onto a coating material having deposited thereon a large amount of solder for a hard-to-solder material such as Kovar and 42-alloy and onto a hard-to-solder material, the method comprising the steps of electroplating a portion to be soldered of a hard-to-solder material and allowing the hard-to-solder material to pass through ultrasonic wave-applied molten solder to thereby deposit a large amount of solder onto the portion to be soldered only.

(57) 要約:

本発明は、コパール、42アロイ等の難はんだ付け材料はんだを大量に付着させたはんだコーティング材および難はんだ付け材料にフラックスなしで充分なはんだを付着させることができる方法であって、難はんだ付け材料のはんだ付け部に電気めっきを施しておき、次いで難はんだ付け材料を超音波が付加された熔融はんだ中を通過させて、はんだめっき部だけに大量のはんだを付着させることができる。

100280-22589860

WO 01/28726 A1